

16ビット、250KSPS サンプルング CMOS ADコンバータ

特 長

- 工業標準入力範囲： $\pm 10\text{V}$
- SNR：90dB (20kHz入力時 (Min))
- INL： $\pm 2.0\text{LSB}$ (Max)
- DNL： $\pm 1\text{LSB}$ (Max)
- 16ビット ノー・ミッシング・コード
- アナログ電源 (V_{ANA})：4.75V～5.25V
- I/O電源電圧 (V_{DIG})：1.65V～5.25V
- ADS7805/10 (低速)、ADS7804/8504とピン配列互換性
- 内部または、外部リファレンスを使用可能
- パラレル・データ出力
- 消費電力：100mW (250KSPS時 (Typ))
- 28ピンSSOPパッケージ

アプリケーション

- 産業用プロセス制御
- データ・アキュイジション・システム

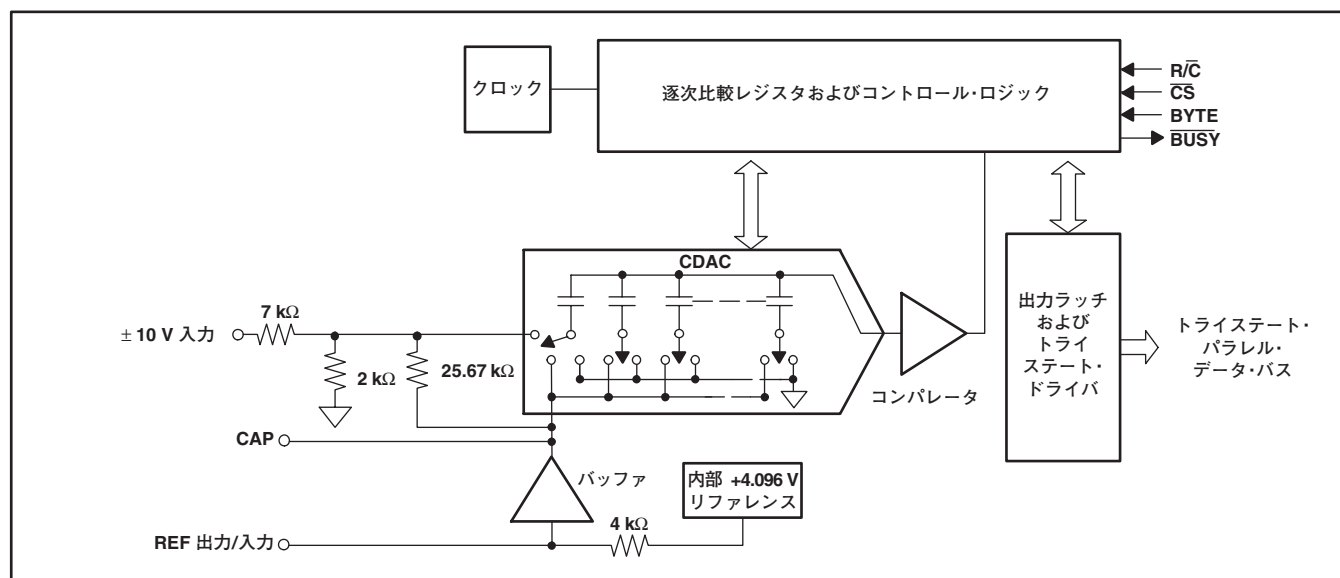
- デジタル信号処理
- 医療用機器
- 計装機器

概 要

ADS8515は、最新のCMOS構造を採用した16ビット・サンプルリングADコンバータ (ADC) です。またADS8515は、16ビット、電荷再分配方式の逐次比較型 (SAR) ADコンバータであり、サンプル・ホールド、リファレンス、クロック回路、マイクロプロセッサ用のインターフェイス、およびトライ・ステート出力ドライバ、全てを備えています。

ADS8515は、 $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ の範囲で250kHzのサンプルング・レートが規定されています。斬新な設計により、+5V単電源で動作しながら高精度の抵抗で工業標準の $\pm 10\text{V}$ 入力範囲を実現し、消費電力は100mWを下回ります。

ADS8515は28ピンSSOPパッケージで供給され、産業用の $-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ の温度範囲で動作が規定されています。



すべての商標および登録商標は、それぞれの所有者に帰属します。

この資料は、Texas Instruments Incorporated (TI) が英文で記述した資料を、皆様のご理解の一助として頂くために日本テキサス・インスツルメンツ (日本TI) が英文から和文へ翻訳して作成したものです。資料によっては正規英語版資料の更新に対応していないものがあります。日本TIによる和文資料は、あくまでもTI正規英語版をご理解頂くための補助的参考資料としてご使用下さい。製品のご検討およびご採用にあたりましては必ず正規英語版の最新資料をご確認下さい。TIおよび日本TIは、正規英語版にて更新の情報を提供しているにもかかわらず、更新以前の情報に基づいて発生した問題や障害等につきましては如何なる責任も負いません。



静電気放電対策

これらのデバイスは、限定的なESD（静電破壊）保護機能を内蔵しています。保存時または取り扱い時に、MOSゲートに対する静電破壊を防止するために、リード線どうしを短絡しておくか、デバイスを伝導性のフォームに入れる必要があります。

製品情報⁽¹⁾

製品名	最小 INL (LSB)	ノー・ミッシング・コード	最小 SINAD (dB)	仕様温度範囲	パッケージ・リード	パッケージ・コード	製品型番	出荷形態、数量
ADS8515IB	±2	16	89	-40°C ~ 85°C	SSOP-28	DB	ADS8515IBDB	チューブ、50
							ADS8515IBDBR	テープ・リール、2000
ADS8515I	±3	16	87	-40°C ~ 85°C	SSOP-28	DB	ADS8515IDB	チューブ、50
							ADS8515IDBR	テープ・リール、2000

(1) 最新のパッケージ情報と発注情報については、このデータシートの末尾にある、追補：「パッケージ・オプション」を参照するか、または www.tij.co.jp にある TI の Web サイトを参照してください。

絶対最大定格⁽¹⁾

ADS8515		
アナログ入力	V_{IN}	±25V
	CAP	AGND2 - 0.3 V ~ + V_{ANA} + 0.3 V
	REF	AGND2へ永久接続、 V_{ANA} へ瞬時短絡
グラウンド間の電位差	DGND, AGND1, AGND2	±0.3 V
	V_{ANA}	6 V
	$V_{DIG} \sim V_{ANA}$	0.3 V
	V_{DIG}	6 V
デジタル入力		-0.3V ~ + V_{DIG} + 0.3V
最大接合温度		165°C
消費電力		825 mW
リード温度（半田付け10秒）		300°C

- (1) 絶対最大定格を超えるストレスは、デバイスに永久的な損傷を与えます。絶対最大定格の状態では長時間動作させると、デバイスの信頼性が低下します。これはストレスの定格のみについて示しており、本製品の仕様を超える状態での機能動作を意味するものではありません。
- (2) 電圧値はすべてネットワーク・グラウンド端子を基準としています。

電気的特性

$T_A = -40^\circ\text{C} \sim +85^\circ\text{C}$ 、 $f_s = 250\text{kHz}$ 、 $V_{DIG} = V_{ANA} = 5\text{V}$ 、内部リファレンス使用（特に記述のない限り）

パラメータ		テスト条件	ADS8515I			ADS8515IB			単位
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
分解能					16			16	Bits
アナログ入力									
電圧範囲				±10			±10		V
インピーダンス				8.885			8.885		kΩ
入力容量				75			75		pF
スループット速度									
変換サイクル時間		Acquire and convert			4		4		μs
スループット・レート			250			250			kHz
DC精度									
INL	積分直線性誤差		-3		3	-2		2	LSB ⁽¹⁾
DNL	微分直線性誤差		-1		2	-1		1	LSB ⁽¹⁾
ノー・ミッシング・コード				16			16		Bits
トランジション・ノイズ ⁽²⁾				0.67			0.67		LSB

(1) LSB は「least significant bit」の略で、最下位ビットを表します。16bit、±10V入力するとき、ADS8515では、1LSBは305μVです。

(2) ノイズの実効値 (Typ) は、トランジションと温度がワースト・ケースの値です。

電気的特性

$T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 、 $f_s = 250\text{kHz}$ 、 $V_{\text{DIG}} = V_{\text{ANA}} = 5\text{V}$ 、内部リファレンス使用 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	ADS8515I			ADS8515IB			単位
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
フルスケール誤差 ⁽³⁾⁽⁴⁾		内部リファレンス	-0.5		0.5	-0.25		0.25	%FSR
フルスケール誤差ドリフト		内部リファレンス		±7			±7		ppm/°C
フルスケール誤差 ⁽³⁾⁽⁴⁾		外部4.096Vリファレンス	-0.25		0.25	-0.1		0.1	%FSR
フルスケール誤差ドリフト		外部4.096Vリファレンス		±2			±2		ppm/°C
バイポーラ・ゼロ誤差 ⁽⁵⁾			-4		4	-2		2	mV
バイポーラ・ゼロ誤差ドリフト				±2			±2		ppm/°C
電源感度 (V _{DIG} = V _{ANA} = V _D)		+4.75 V < V _D < +5.25 V	-8		8	-8		8	LSB
AC精度									
SFDR	スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ	f _i = 20 kHz	95	102		97	102		dB ⁽⁵⁾
THD	全高調波歪み	f _i = 20 kHz		-100	-94		-100	-96	dB
SINAD	信号対(ノイズ + 歪み)	f _i = 20 kHz	87	91		89	91		dB
		-60-dB Input		30		32		dB	
SNR	信号対ノイズ比	f _i = 20 kHz	88	92		90	92		dB
	フルパワー帯域幅 ⁽⁶⁾			500			500		kHz
サンプリング・ダイナミック									
	アパーチャ遅延			5			5		ns
	トランジェント応答	フルスケール・ステップ			2			2	μs
	過電圧復帰 ⁽⁷⁾			150			150		ns
リファレンス電圧									
	内部リファレンス電圧		4.076	4.096	4.116	4.076	4.096	4.116	V
	内部リファレンス出力電流 (外部バッファ使用のこと)			1			1		μA
	内部リファレンスドリフト			8			8		ppm/°C
	直線性仕様を満たす外部 リファレンス電圧範囲		3.9	4.096	4.2	3.9	4.096	4.2	V
	外部リファレンスからの流入電流	外部4.096Vリファレンス			100			100	μA
デジタル入力									
	ロジック・レベル								
V _{IL}	“L” レベル入力電圧	V _{DIG} = 1.65 V ~ 5.25 V	-0.3		0.8	-0.3		0.35×V _{DIG}	V
V _{IH}	“H” レベル入力電圧	V _{DIG} = 1.65 V ~ 5.25 V	2.0		V _{DIG} +0.3 V	0.65×V _{DIG}		V _{DIG} +0.3 V	V
I _{IL}	“L” レベル入力電流	V _{IL} = 0 V			±10			±10	μA
I _{IH}	“H” レベル入力電流	V _{IH} = 5 V			±10			±10	μA
デジタル出力									
データ・フォーマット (パラレル16ビット)									
データ・コード (2の補数バイナリ)									
V _{OL}	“L” レベル出力電圧	I _{SINK} = 1.6 mA			0.4			0.4	V
V _{OH}	“H” レベル出力電圧	I _{SOURCE} = 500 μA			0.8 × V _{DIG}			0.8 × V _{DIG}	V
	リーク電流	ハイ・インピーダンス時 V _{OUT} = 0 V ~ V _{DIG}			±5			±5	μA
	出力容量	ハイ・インピーダンス時			15			15	pF
デジタル・タイミング									
	バス・アクセス・タイミング				83			83	ns
	バス解放タイミング				83			83	ns

(3) 図25 (a) に示す抵抗値で測定。外部ポテンショメータによりゼロに調整。

(4) フルスケール誤差は、入力が最小値コードから最大値コードに変化したときの-フルスケール、または+フルスケールの理論値に対する偏差のワースト・ケースであり、変化した電圧 (フルスケール・レンジではなく) で除算し、オフセットによる誤差が含まれます。

(5) dB表示は、すべてフルスケールの $\pm 10\text{V}$ 入力を基準としています。

(6) フルパワー帯域幅は、フルスケール入力において、信号対(ノイズ + 歪み)が60dBに低下する時、もしくは精度が10ビットに低下する時の周波数として規定されています。

(7) $2 \times \text{FS}$ の入力過電圧を印加後、規定の特性に復帰するまでの時間。

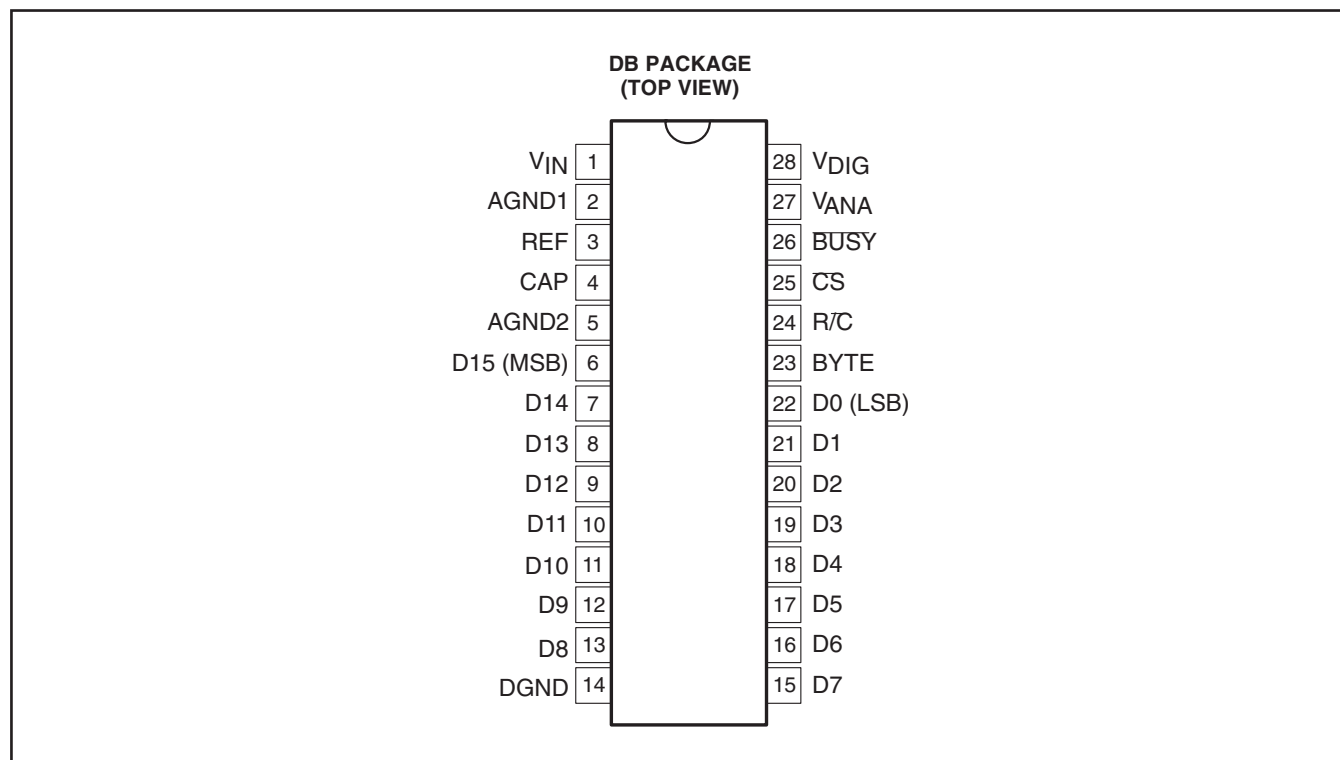
電気的特性

$T_A = -40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$ 、 $f_s = 250\text{kHz}$ 、 $V_{\text{DIG}} = V_{\text{ANA}} = 5\text{V}$ 、内部リファレンス使用 (特に記述のない限り)

パラメータ		テスト条件	ADS8515I			ADS8515IB			単位
			MIN	TYP	MAX	MIN	TYP	MAX	
電源									
V _{DIG}	デジタル電源電圧	V _{ANA} 以下であること。	1.65		5.25	1.65		5.25	V
V _{ANA}	アナログ電源電圧		4.75	5	5.25	4.75	5	5.25	V
I _{DIG}	デジタル電源電流			0.1	1		0.1	1	mA
I _{ANA}	アナログ電源電流			20	25		20	25	mA
消費電力		f _S = 250 kHz		100	125		100	125	mW
動作温度範囲									
規定			−40		85	−40		85	°C
ディレーティング ⁽⁸⁾			−55		125	−55		125	°C
ストレージ			−65		150	−65		150	°C
熱抵抗 ^(9JA)									
SSOP				67			67		°C/W

(8) 内部リファレンスは産業用温度範囲 ($-40^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$) 外では動作を開始しないことがあります。その場合、外部リファレンスを使用することを推奨します。

ピン配置



ピン構成

端子		デジタル 入出力	説 明
名称	ピン 番号		
AGND1	2		アナログ・グランド。内部のグランド基準点として使用します。
AGND2	5		アナログ・グランド。
BUSY	26	O	BUSYは変換の開始で“Low”になり、変換が完了してデジタル出力が更新されるまで“Low”のままです。
BYTE	23	I	上位8ビット(low)あるいは下位8ビット(high)を選択します。
CAP	4		リファレンス・バッファ用コンデンサ。グランドへ2.2μFのタンタル・コンデンサを接続します。
CS	25	I	R/Cと内部でOR接続。R/Cが“Low”の場合、CSの立ち下がりがエッジで新規の変換を開始します。
DGND	14		デジタル・グランド
D15 (MSB)	6	O	データ・ビット15。変換結果の最上位ビット(MSB)。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D14	7	O	データ・ビット14。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D13	8	O	データ・ビット13。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D12	9	O	データ・ビット12。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D11	10	O	データ・ビット11。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D10	11	O	データ・ビット10。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D9	12	O	データ・ビット9。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D8	13	O	データ・ビット8。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D7	15	O	データ・ビット7。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D6	16	O	データ・ビット6。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D5	17	O	データ・ビット5。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D4	18	O	データ・ビット4。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D3	19	O	データ・ビット3。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D2	20	O	データ・ビット2。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。
D1	21	O	データ・ビット1。CSが“High”またはR/Cが“Low”のとき、ハイ・インピーダンスです。

ピン構成

D0 (LSB)	22	O	データ・ビット0。変換結果の最下位ビット (LSB)。 $\overline{CS}$ が “High” または $R/\overline{C}$ が “Low” のとき、ハイ・インピーダンスです。
$R/\overline{C}$	24	I	$\overline{CS}$ が “Low” かつ $\overline{BUSY}$ が “High” のとき、 $R/\overline{C}$ の立ち下がりエッジで新規の変換を開始します。 $\overline{CS}$ が “Low” のとき、 $R/\overline{C}$ の立ち上がりエッジでパラレル出力をイネーブルします。
REF	3		リファレンス入力/出力。グランドへ2.2 μ Fのタンタル・コンデンサを接続します。
V_{ANA}	27		アナログ電源入力。公称値+5V。0.1 μ Fのセラミックと10 μ Fのタンタル・コンデンサでグランドへデカップリングします。
V_{DIG}	28		デジタル電源入力。公称値+5V。27ピンに直に接続します。 V_{ANA} 以下であること。
V_{IN}	1		アナログ入力。図24参照。

代表的特性

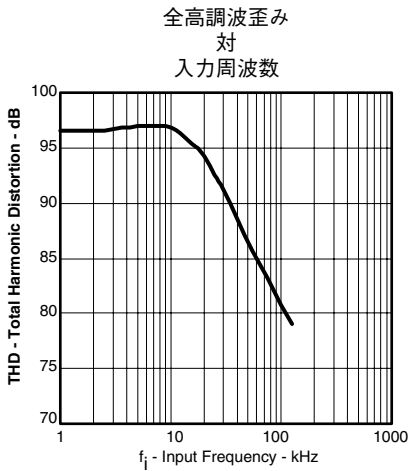


図 1

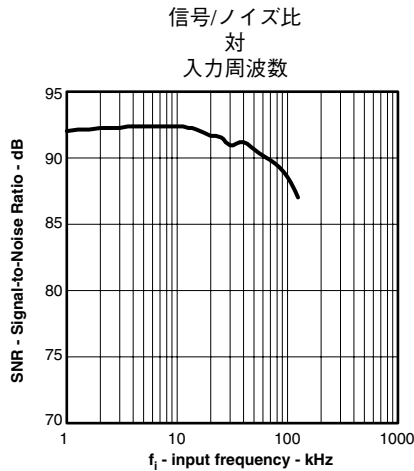


図 2

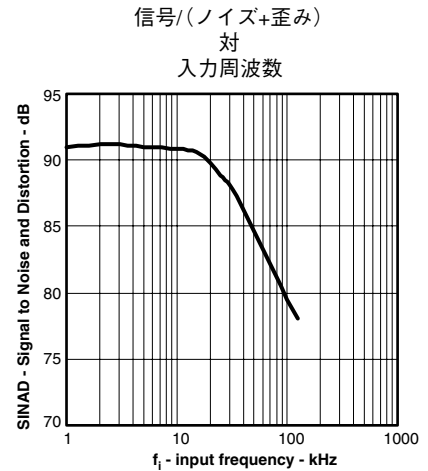


図 3

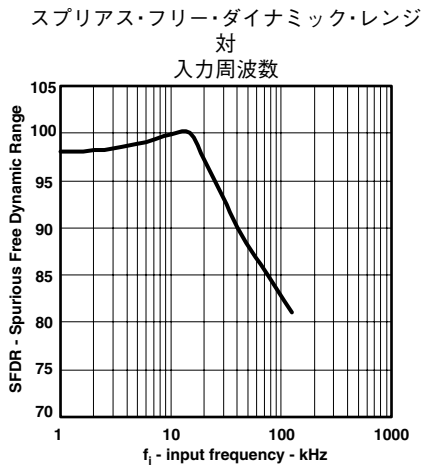


図 4

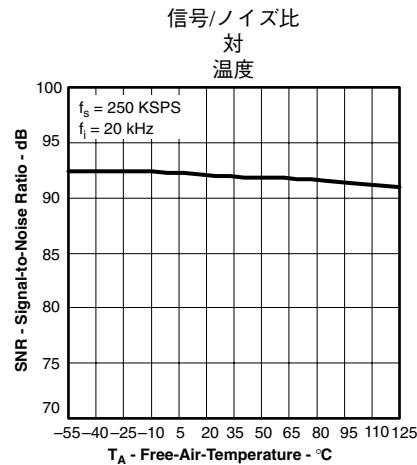


図 5

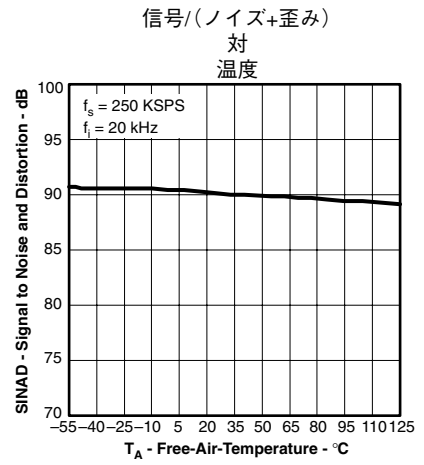


図 6

代表的特性

スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ
対
温度

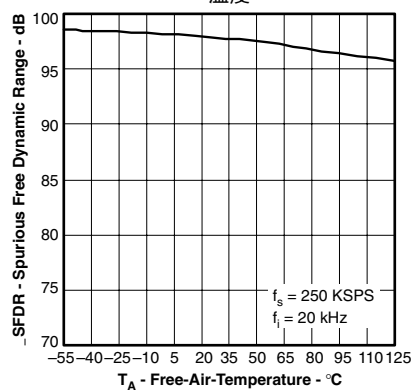


図 7

全高調波歪み 対 温度

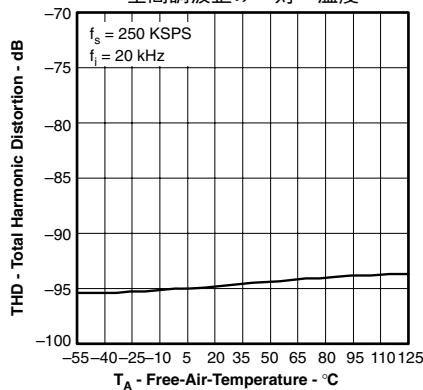


図 8

内部リファレンス電圧 対 温度

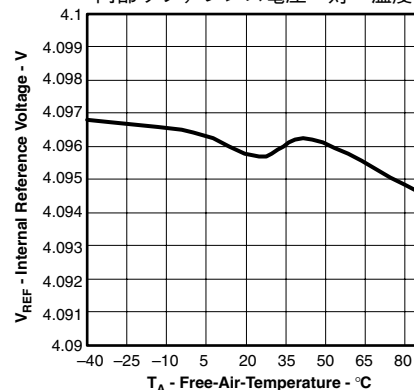


図 9

バイポーラ・ゼロ誤差
対
温度

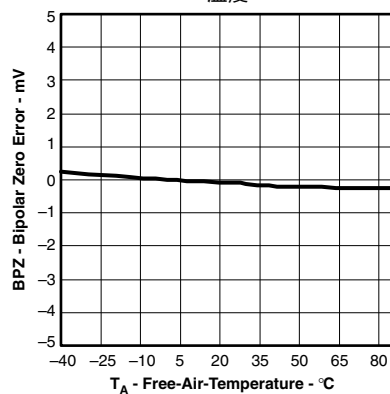


図 10

負フルスケール誤差
対
温度

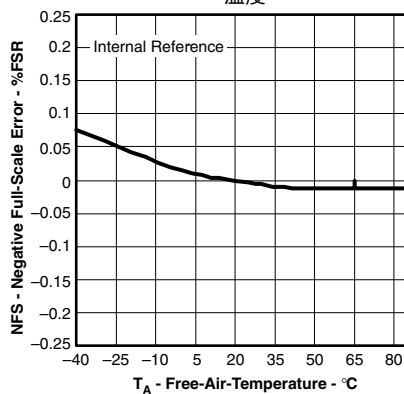


図 11

負フルスケール誤差
対
温度

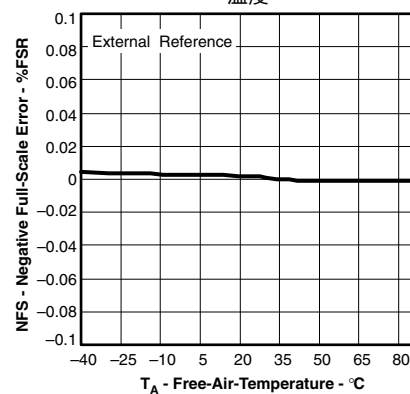


図 12

正フルスケール誤差
対
温度

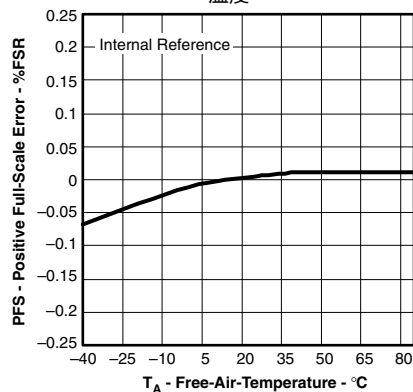


図 13

正フルスケール誤差
対
温度

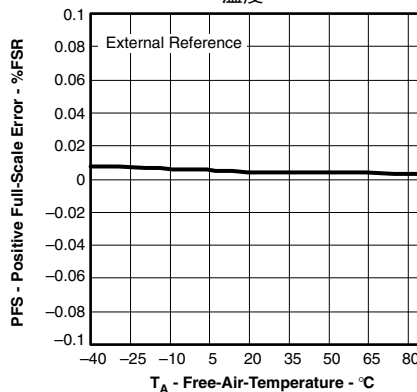


図 14

電源電流 対 温度

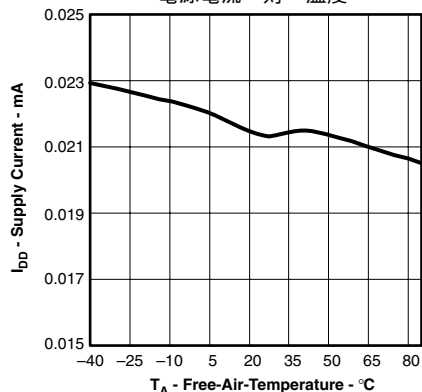


図 15

代表的特性

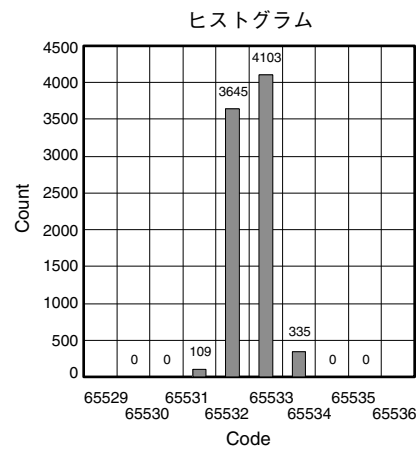


図 16

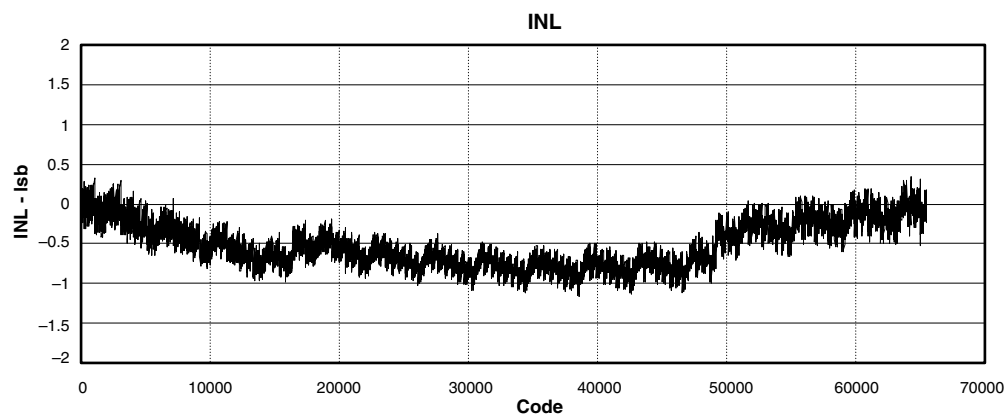


図 17

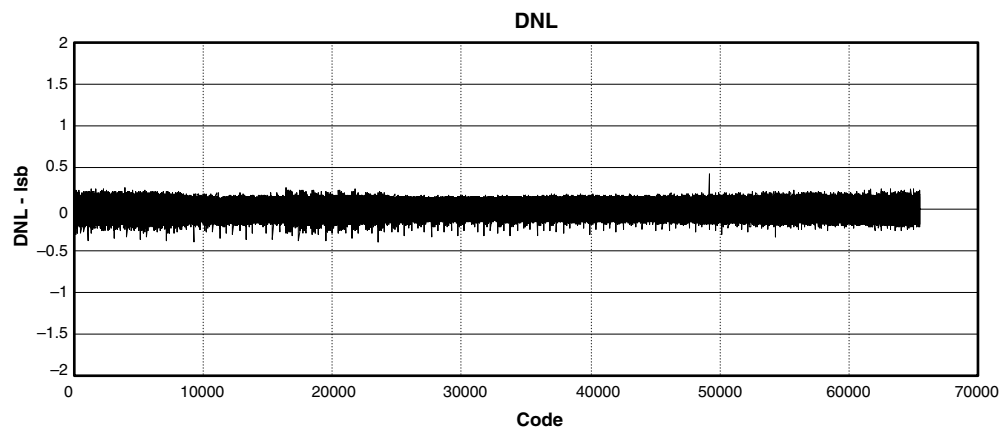


図 18

基本動作

図19にADS8515がパラレル・データ出力動作をする基本回路を示します。R/C(24ピン)を40ns以上“Low”にすると、変換を開始します。そしてBUSY(26ピン)が“Low”になり、変換が完了し出力レジスタを更新するまでBUSYを“Low”に保持します。データは2の補数バイナリ・フォーマットで出力し、6ピンがMSBです。BUSYの立ち上がりエッジを、データのラッチに使用する事ができます。

ADS8515は変換終了時に入力信号のトラッキングを始めます。変換コマンドの間隔を4μs確保すると、信号を正確にアクイジションすることができます。

変換の開始

CS(25ピン)とR/C(24ピン)の両方を最低40nsの間“Low”にすると、直ちにADS8515のサンプル/ホールドがホールド状態になり、変換“n”を開始します。BUSY(26ピン)が“Low”になり、変換“n”が完了して内部の出力レジスタが更新されるまでBUSYの“Low”が保持されます。

ADS8515は変換の終わりに入力信号のトラッキングを始めるので、変換コマンドの間隔を4μs確保すると、信号の変化に正確に追従したアクイジションとすることができます。CS、R/CおよびBUSYの各状態については表1を、タイミング図は図21、図22、および図23を参照してください。

CSとR/Cは内部でOR接続されておりレベル・トリガーとなっていますので、変換を開始する際、どちらの入力が先に“Low”になるかという条件はありません。しかし、CSあるいはR/Cにより変換“n”を開始しようとする時、タイミングの重要でない入力を開始タイミングを決める入力よりも少なくとも10ns先行させる必要があります。

制御端子の数を少なくするには、CSを“Low”に固定し、R/Cをリードおよび変換モードの制御に使用することができます。R/Cが“High”になると、パラレル出力は常にアクティブになります。以上については、「データの読み取り」項を参照してください。

CS	R/C	BUSY	動作
1	X	X	なし。データ・バスはハイ・インピーダンス状態。
↓	0	1	変換“n”の開始。データ・バスはハイ・インピーダンス状態のまま。
0	↓	1	変換“n”の開始。データ・バスはハイ・インピーダンス状態に入る。
0	1	↑	変換“n”の終了。変換“n”の有効データがデータ・バス上にある。
↓	1	1	変換“n”の有効データがあり、データ・バスをイネーブルにする。
↓	1	0	変換“n-1” ⁽¹⁾ の有効データがあり、データ・バスをイネーブルにする。変換“n”は進行中。
0	↑	0	変換“n-1” ⁽¹⁾ の有効データがあり、データ・バスをイネーブルにする。変換“n”は進行中。
0	0	↑	新信号を収集せずに新しい変換を開始。データは無効。BUSYが“High”になるとき、CSおよびR/Cの両方あるいは一方が“High”であること。
X	X	0	変換“n”が進行中。

表 1. リードおよび変換に関する制御ライン機能

(1) 変換“n-1”からの有効データに関する制約については、図21および図22を参照。

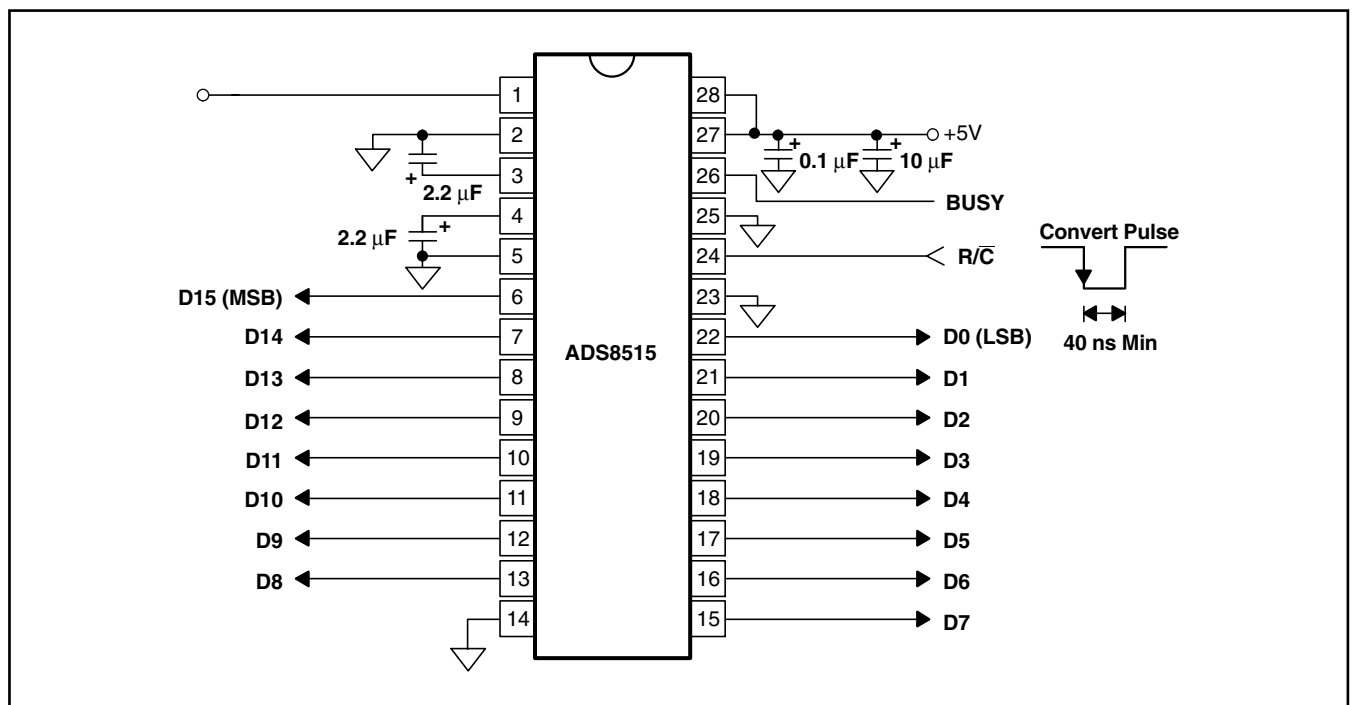


図 19. 基本動作

解 説	アナログ入力	デジタル出力は、2の補数バイナリ	
		バイナリ・コード	ヘキサ・コード
フルスケール範囲	$\pm 10\text{ V}$		
最下位ビット (LSB)	$305\text{ }\mu\text{V}$		
フルスケール (10V-1LSB)	9.999695 V	0111 1111 1111 1111	7FFF
ミッドスケール	0 V	0000 0000 0000 0000	0000
ミッドスケールの1LSB下	$-305\text{ }\mu\text{V}$	1111 1111 1111 1111	FFFF
-フルスケール	-10 V	1000 0000 0000 0000	8000

表 2. 理想入力電圧と出力コード

データの読み取り

ADS8515は、2の補数バイナリのデータ出力フォーマットで、フルあるいはバイト単位読み取りの平行データ出力します。平行データ出力は、 $R/\overline{C}$ (24ピン) が “High” かつ $\overline{CS}$ (25ピン) が “Low” のときにアクティブです。 $\overline{CS}$ と $R/\overline{C}$ の他の組み合わせでは、すべて平行出力はトライ・ステートになります。有効な変換データは、フル・平行の16ビット・ワードまたは2個の8ビット・バイトで、6～13ピンおよび15～22ピンにて読み取ることができます。また、BYTE (23ピン) をトグルすると、1変換サイクル内で2バイトを読み取ることができます。理想的な出力コードについては表2を、BYTEの状態によるビット・ロケーションについては図20を参照してください。

平行出力 (変換後)

変換 “n” が完了して出力レジスタが更新された後、 $\overline{BUSY}$ (26ピン) が “High” になります。このとき、変換 “n” の有効データは、D15～D0 (6～13および15～22ピン) で得られます。 $\overline{BUSY}$ の “High” になるのを利用してデータをラッチすることができます。以上のタイミング仕様については、表3と図21、図22、および図23を参照してください。

平行出力 (変換中)

変換 “n” が開始された後、変換 “n-1” の有効なデータを読み取ることができます。このデータは変換 “n” の開始から最大 t_v まで有効です。変換 “n” の開始の t_v 後から $\overline{BUSY}$ (26ピン) が “High” になるまでの間、データの読み取りを行なってはいけません。これは、無効データを読み取ることになります。以上のタイミング仕様については、表3と図21、図22、および図23を参照してください。

注意： 最高の性能を得るには、変換中にデータを読み取らないで下さい。非同期データ伝送のスイッチング・ノイズによりデジタル・フィードスルーが生じ、コンバータの性能が低下します。

$\overline{CS}$ を “Low” に接続しながら、 $R/\overline{C}$ の立ち下がりエッジを変換開始に使用し、 $R/\overline{C}$ の立ち上がりコンバータの出力モードのイネーブルに使用すると、制御ラインの数を低減することができます。これについては図21をご覧ください。

記号	説 明	MIN	TYP	MAX	単位
t_{w1}	変換開始パルス幅	40			ns
t_a	$R/\overline{C}$ “Low” 後の有効データアクセス時間		0.8	1.2	μs
t_{pd}	$R/\overline{C}$ “Low” から $\overline{BUSY}$ “Low” までの伝播遅延時間		6	20	ns
t_{w2}	$\overline{BUSY}$ “Low” パルス幅			2	μs
t_{d1}	変換終了から $\overline{BUSY}$ の立ち上がりまでの遅延時間		5		ns
t_{d2}	アパーチャ遅延時間		5		ns
t_{conv}	変換時間			2	μs
t_{acq}	アキュイジション時間	2			μs
t_{dis}	バス・ディセーブル時間	10	15	83	ns
t_{d3}	データ有効から $\overline{BUSY}$ の立ち上がりまでの遅延時間	35	50		ns
t_v	$R/\overline{C}$ “Low” 後に先のデータが有効である時間	1.5	2		μs
$t_{conv} + t_{acq}$	スループット時間			4	μs
t_{su}	セットアップ時間、 $R/\overline{C}$ と $\overline{CS}$ の関係	10			ns
t_c	コンバージョン・サイクル・タイム	4			μs
t_{en}	バス・イネーブル時間	10	15	30	ns
t_{d4}	BYTE遅延時間	10	15	30	ns

表 3. 変換タイミング

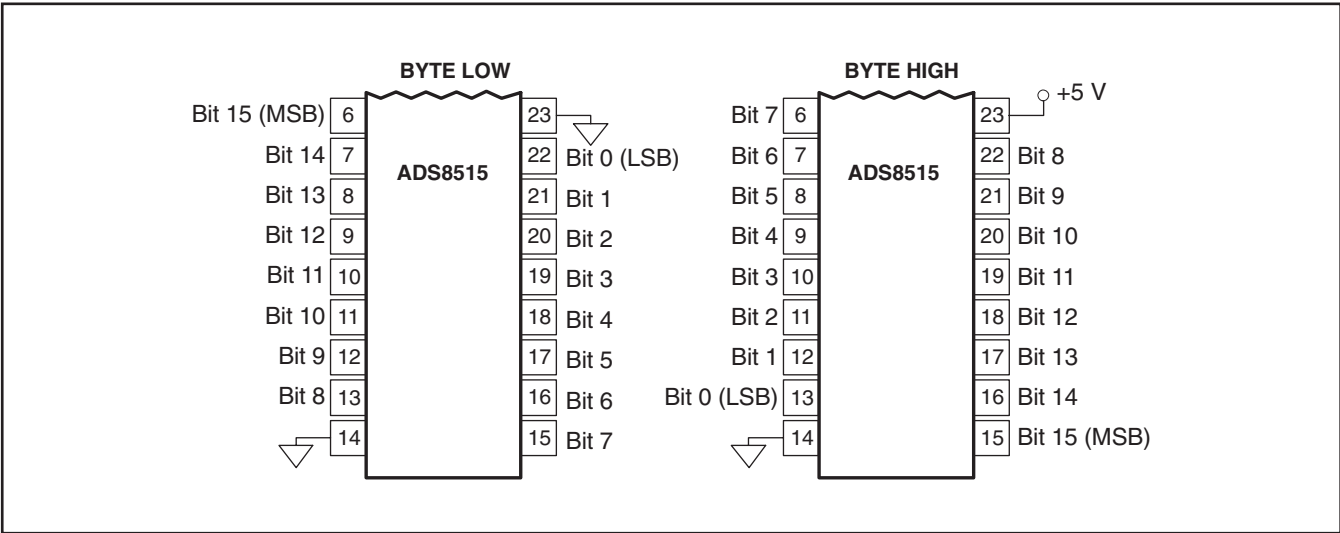


図 20. BYTE (23ピン)の状態に対するビット・ロケーション

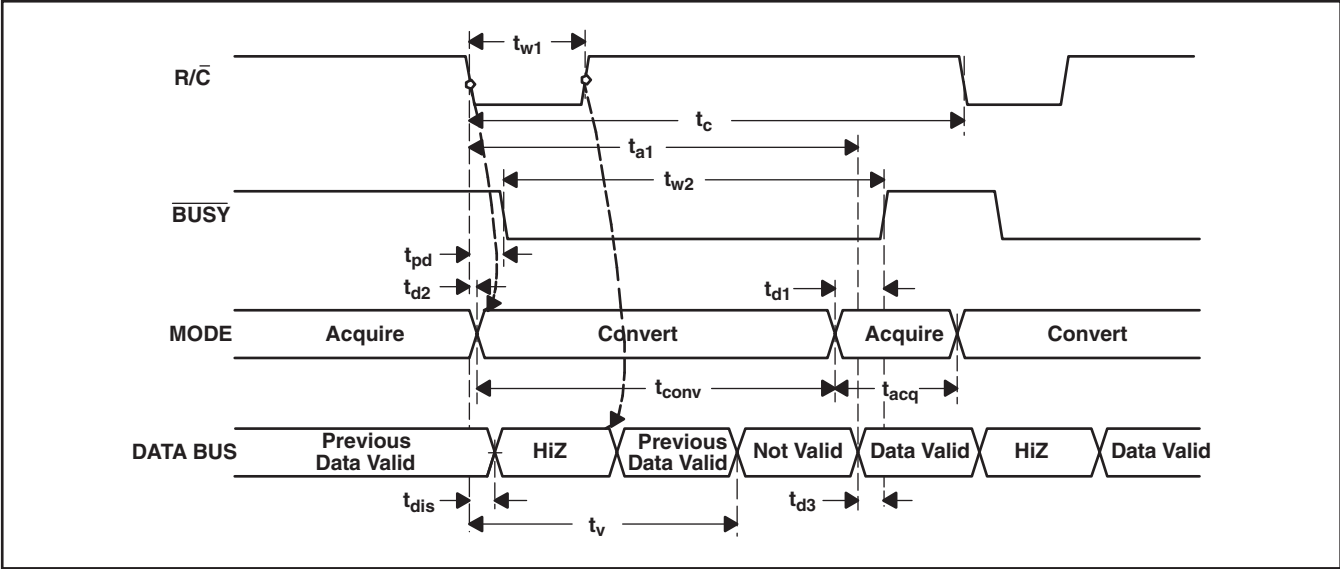


図 21. 変換後の出力イネーブルの変換タイミング ($\overline{CS}$ を“Low”に固定)

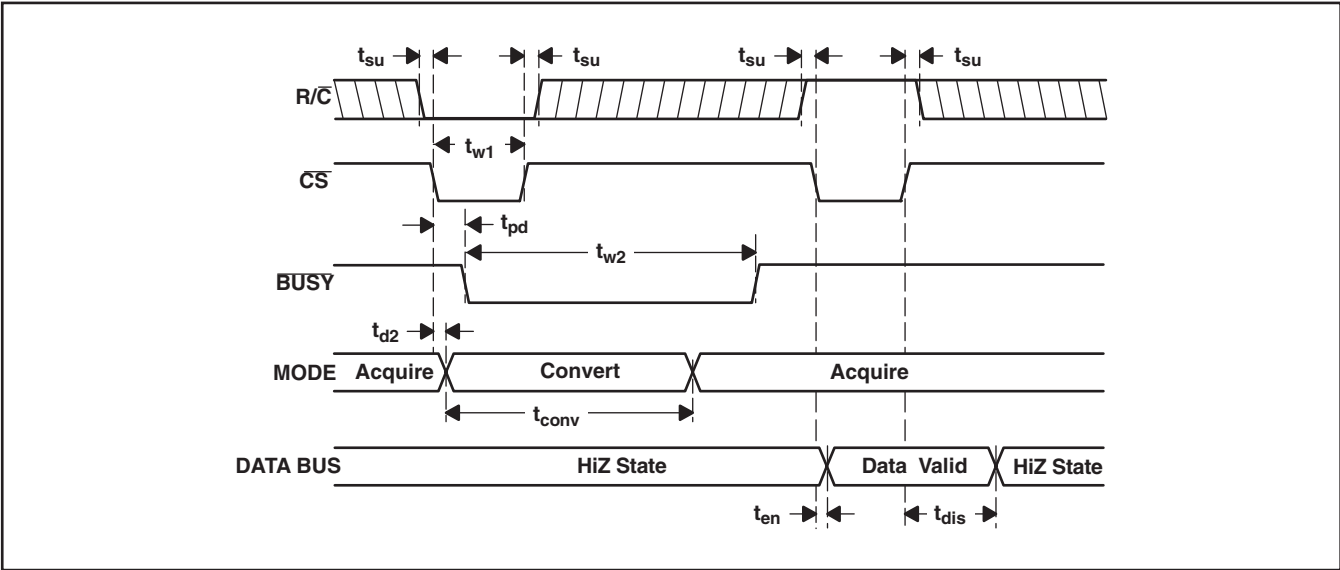


図 22. $\overline{CS}$ を使用する場合の変換およびリード制御のタイミング

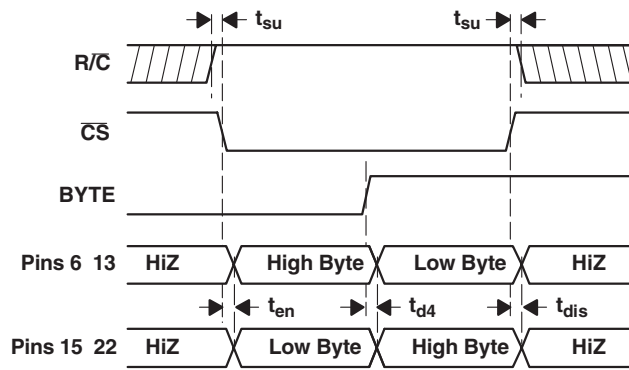


図 23. データ・バスの制御に $\overline{CS}$ とBYTEを使用

ADCリセット

ADS8515のADCリセット機能を使用して、現行の変換サイクルを終了することができます。BUSYが“Low”の間に $R/\overline{C}$ を最低40nsの間“Low”にすると、ADCのリセットが開始されます。新しく変換を開始するには $R/\overline{C}$ が“High”状態に戻し、次の変換を開始するために“Low”にする前に、新しいデータを収集するのに十分な時間(表3の t_c を参照)、 $R/\overline{C}$ は“High”を保持する必要があります。BUSY信号を監視しないアプリケーションでは、システムの初期化シーケンスの一部としてADCリセット機能を実装することを推奨します。

入力範囲

ADS8515は標準の $\pm 10V$ 入力範囲を備えています。図25に、外部トリムが有る場合と無い場合のADS8515に必要な回路接続を示します。ADS8515のオフセットおよびフルスケール誤差の仕様は、図25 (b) に示す回路で試験および規定されています。フルスケール誤差には、+FSと-FSの両方で測定されたオフセットおよびゲイン誤差が含まれています。オフセットとゲインの調整については、本データシートの「キャリブレーション」節で解説しております。

オフセットとゲインは、単電源の外部トリムが可能であるようにデバイス内部で調整されています。外付け抵抗はこの調整分を補償します。また、オフセットとゲインがソフトウェアで修正される場合、この抵抗は外すことができます（「キャリブレーション」節を参照）。

入力インピーダンスの公称値6.35k Ω は、本製品データシートの始めのページで示す内部抵抗網の組み合わせから得られています。この入力抵抗分圧網により、最小 $\pm 25V$ の過電圧保護が達成されています。外付け回路で1%精度の抵抗を使用すると、コンバータの精度およびドリフト特性が悪化しません。1%精度の抵抗は内部抵抗に対してほとんど影響せず、それ以上の精度は必要ありません。

入力信号はAGND1を基準とする必要があります。それによって、アナログ設計にありがちなグラウンド・ループ問題が最小限に抑えられます。アナログ信号は低インピーダンス信号源によってドライブします。OPA627やOPA132を使用した標準的なドライブ回路を図24に示します。

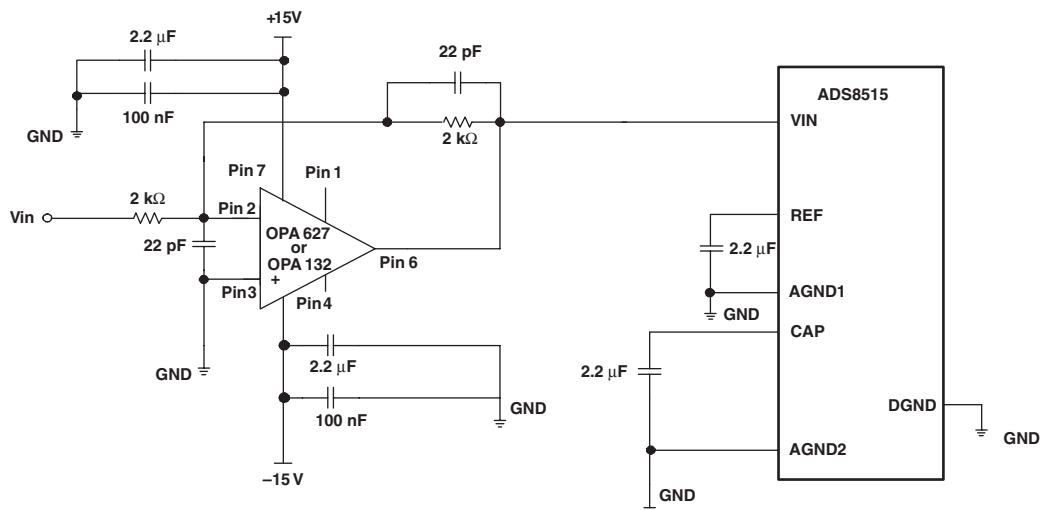


図 24. 標準的なドライブ回路($\pm 10V$, 外部トリムなし)

アプリケーション情報

キャリブレーション

ADS8515のゲインは、ソフトウェアでトリムすることができます。最適な特性を実現するには、数回の反復調整が必要になります。

ハードウェア・キャリブレーション

ADS8515のゲインをトリムするため図25(a)に示す抵抗と可変抵抗から成る回路を実装します。ADS8515のゲインの調整範囲はおおよそ $\pm 100\text{mV}$ になります。

ソフトウェア・キャリブレーション

ADS8515のオフセットとゲインはソフトウェアで校正することができます。その回路接続は図25(b)をご覧ください。

基準電圧

ADS8515は、内部の4.096Vリファレンスあるいは外部リファレンスで動作できます。外部リファレンスを5ピンに供給すると、内部リファレンスはバイパスされます。REF端子におけるリファレンスは内部でバッファされ、CAP端子(4ピン)に出力されます。

内部リファレンスには $8\text{ppm}/^\circ\text{C}$ (Typ) のドリフトがあり、フルスケール誤差(低グレード版で $\text{FSE} = \pm 0.5\%$ 、高グレード版で $\text{FSE} = \pm 0.25\%$)のおおよそ20%を占めています。

REF端子

REF端子(3ピン)は外部リファレンスには入力であり、内部4.096V基準電圧には出力になります。REF端子には、 $2.2\mu\text{F}$ の

コンデンサをできるだけ近くに接続します。このコンデンサとREFの出力抵抗によりローパス・フィルタが形成され、リファレンスのノイズ帯域を制限します。より小さい値のコンデンサを使用した場合、より多くのノイズがリファレンスに乗り、SNRおよびSINADが低下します。REF端子は、外部のACあるいはDC負荷のドライブに使用してはなりません。

外部リファレンスの範囲は3.9Vから4.2Vであり、これによって実際のLSBサイズが定まります。リファレンス電圧を高くすると、コンバータのフルスケール範囲およびLSBサイズが大きくなり、SNRを改善することができます。

CAP端子

CAP端子(4ピン)は内部リファレンス・バッファの出力です。CAP端子には $2.2\mu\text{F}$ のコンデンサをできるだけ近くに接続して、変換サイクルの間CDACに最適なスイッチング電流を供給し、また、内部バッファ出力の補償を行います。 $1\mu\text{F}$ より小さいコンデンサを使用すると、出力バッファに発振が生じ、さらにCDACへの充電電荷が不足します。 $2.2\mu\text{F}$ より大きな値のコンデンサは、特性の改善にほとんど寄与しません。これら補償用コンデンサのESR(等価直列抵抗)も重要です。全体のESRは 3Ω より低くしてください。

バッファの出力は、最大2mAの電流をDC負荷にドライブする能力があります。しかし、CAP端子におけるあらゆる外部負荷によりADS8515の直線性は劣化します。外部バッファを使用すると、内部リファレンスはより大きなDC負荷およびAC負荷に使用することができます。CAP端子の出力電圧でAC負荷を直接ドライブしてはなりません。これを行うと、コンバータの性能低下が生じます。

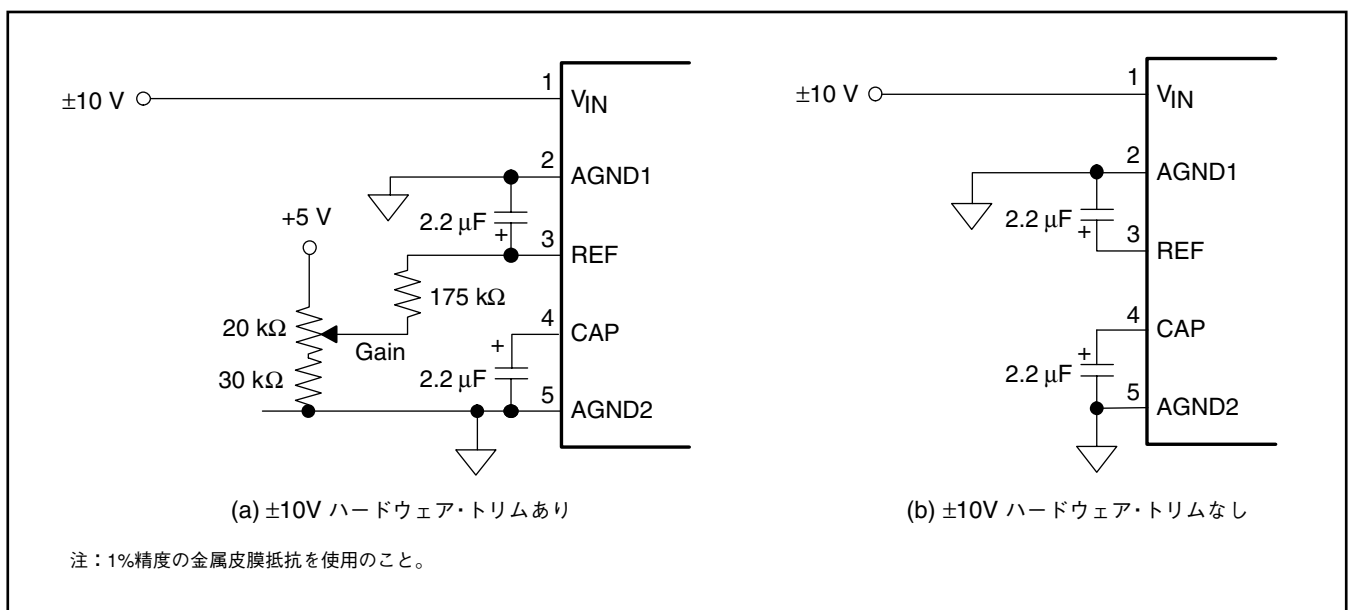


図 25. ソフトウェア・トリミング用の回路図

レイアウト 電源

最適特性を実現するため、アナログおよびデジタルの電源端子は同一の+5V電源に接続し、アナログおよびデジタルのグラウンドは相互に接続します。電氣的仕様で述べたように、ADS8515はその電力の90%をアナログ回路で消費します。したがって、ADS8515はアナログ部品として見なすべきです。

ADコンバータ用の+5V電源は、システムのデジタル・ロジックに使用される+5V電源から分離します。V_{DIG} (28ピン)を直接にデジタル用電源に接続すると、デジタル・ロジックからのスイッチング・ノイズによりコンバータの性能が低下します。最高の性能を得るには、アナログ・シグナル・コンディショニング以外に使用されているアナログ電源から+5V電源を作ります。+12Vや+15V電源がある場合は、単純な+5Vレギュレータが使用できます。勧められることではありませんが、デジタル電源からコンバータに電力を供給しなければならない場合は、その電源を適切にフィルタリングします。フィルタリングしたデジタル電源であれ、レギュレーションしたアナログ電源であれ、それを使用するときはV_{DIG}およびV_{ANA}を同一の+5V電源に接続します。

グラウンドの取り方

3本のグラウンド端子がADS8515にあります。DGNDはデジタル電源用のグラウンドです。AGND2はアナログ電源用グラウンドです。AGND1は、AD内部へのすべてのアナログ信号の基準となるグラウンドです。AGND1は電流誘起による電圧降下に対してより敏感であり、電源への最小抵抗の帰路がなければなりません。

ADのグラウンド端子は、すべてアナログ・グラウンドのプレーンに接続し、システムのデジタル・ロジック・グラウンドから分離して最適な性能を実現します。アナログおよびデジタル・グラウンドのプレーンは、ともに電源にできるだけ近い所でシステム・グラウンドに接続します。このように接続すると、電源グラウンドへの共通インピーダンスを経由して、デジタル・グラウンドのダイナミック電流がアナログ・グラウンドを変調するのを防止します。

シグナル・コンディショニング

多くのCMOS ADコンバータのサンプル・ホールド回路で使用されるFETスイッチは、オペアンプを発振に至らしめる非常に大量のチャージ・インジェクションを生じさせることがあります。ADS8515のFETスイッチは、他のCMOS ADコンバータのFETスイッチに比べ、電荷注入量は5%から10%に過ぎません。また、抵抗性のフロントエンド回路があり、注入されたあらゆる電荷が減衰されます。その結果、フロントエンドにおけるアンチ・エイリアシング・フィルタの要求条件が最小限度に緩和されます。アプリケーションにおいて信号を十分ドライブできるオペアンプならば、ADS8515をも十分にドライブできます。

また、ADS8515は抵抗によるフロントエンド回路により、 $\pm 25\text{V}$ の過電圧から保護されます。ほとんどの場合、このフロントエンドによって外部の入力保護回路が不要になります。

中間ラッチ

ADS8515のパラレル・ポートはトライ・ステート出力ですが、変換中にもバスがアクティブであることが必要の場合は、中間ラッチを使用します。バスが変換中にアクティブでない場合、トライ・ステート出力を使用してADを同一バスの他の周辺装置から分離することができます。また、ADがデータ・バスの唯一の周辺装置である場合も、トライ・ステート出力が使用できます。

中間ラッチは、あらゆるモノリシックADコンバータに役立ちます。ADS8515の内部では、1LSB当り38 μV です。パラレル・ポートの高速スイッチング信号によるトランジェントは、AD出力がトライ・ステートの場合でもサブストレートを経由してアナログ回路と結合し、コンバータの性能劣化の原因になります。

PACKAGING INFORMATION

Orderable part number	Status (1)	Material type (2)	Package Pins	Package qty Carrier	RoHS (3)	Lead finish/ Ball material (4)	MSL rating/ Peak reflow (5)	Op temp (°C)	Part marking (6)
ADS8515IBDB	Active	Production	SSOP (DB) 28	50 TUBE	Yes	Call TI	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	ADS8515I B
ADS8515IBDB.A	Active	Production	SSOP (DB) 28	50 TUBE	Yes	Call TI	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	ADS8515I B
ADS8515IBDBR	Active	Production	SSOP (DB) 28	2000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	ADS8515I B
ADS8515IBDBR.A	Active	Production	SSOP (DB) 28	2000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	ADS8515I B
ADS8515IDB	Active	Production	SSOP (DB) 28	50 TUBE	Yes	Call TI	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	ADS8515I
ADS8515IDB.A	Active	Production	SSOP (DB) 28	50 TUBE	Yes	Call TI	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	ADS8515I
ADS8515IDBR	Active	Production	SSOP (DB) 28	2000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	ADS8515I
ADS8515IDBR.A	Active	Production	SSOP (DB) 28	2000 LARGE T&R	Yes	Call TI	Level-2-260C-1 YEAR	-40 to 85	ADS8515I

⁽¹⁾ **Status:** For more details on status, see our [product life cycle](#).

⁽²⁾ **Material type:** When designated, preproduction parts are prototypes/experimental devices, and are not yet approved or released for full production. Testing and final process, including without limitation quality assurance, reliability performance testing, and/or process qualification, may not yet be complete, and this item is subject to further changes or possible discontinuation. If available for ordering, purchases will be subject to an additional waiver at checkout, and are intended for early internal evaluation purposes only. These items are sold without warranties of any kind.

⁽³⁾ **RoHS values:** Yes, No, RoHS Exempt. See the [TI RoHS Statement](#) for additional information and value definition.

⁽⁴⁾ **Lead finish/Ball material:** Parts may have multiple material finish options. Finish options are separated by a vertical ruled line. Lead finish/Ball material values may wrap to two lines if the finish value exceeds the maximum column width.

⁽⁵⁾ **MSL rating/Peak reflow:** The moisture sensitivity level ratings and peak solder (reflow) temperatures. In the event that a part has multiple moisture sensitivity ratings, only the lowest level per JEDEC standards is shown. Refer to the shipping label for the actual reflow temperature that will be used to mount the part to the printed circuit board.

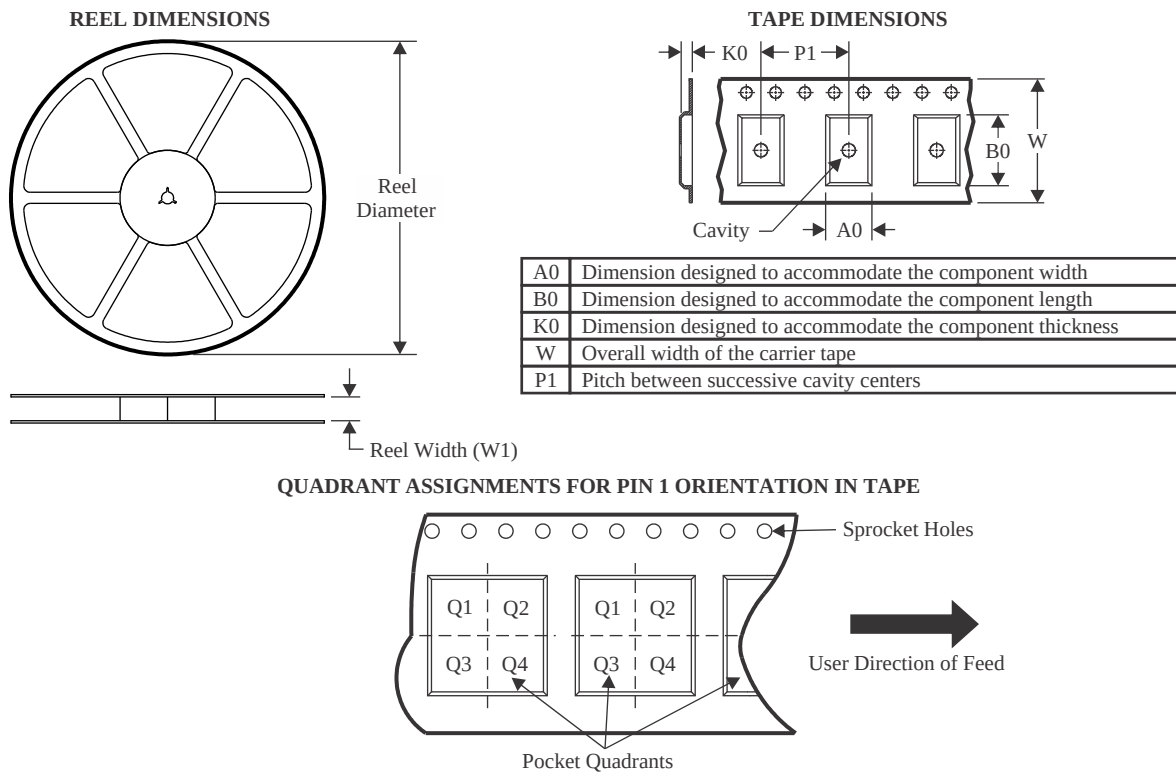
⁽⁶⁾ **Part marking:** There may be an additional marking, which relates to the logo, the lot trace code information, or the environmental category of the part.

Multiple part markings will be inside parentheses. Only one part marking contained in parentheses and separated by a "~" will appear on a part. If a line is indented then it is a continuation of the previous line and the two combined represent the entire part marking for that device.

Important Information and Disclaimer: The information provided on this page represents TI's knowledge and belief as of the date that it is provided. TI bases its knowledge and belief on information provided by third parties, and makes no representation or warranty as to the accuracy of such information. Efforts are underway to better integrate information from third parties. TI has taken and continues to take reasonable steps to provide representative and accurate information but may not have conducted destructive testing or chemical analysis on incoming materials and chemicals. TI and TI suppliers consider certain information to be proprietary, and thus CAS numbers and other limited information may not be available for release.

In no event shall TI's liability arising out of such information exceed the total purchase price of the TI part(s) at issue in this document sold by TI to Customer on an annual basis.

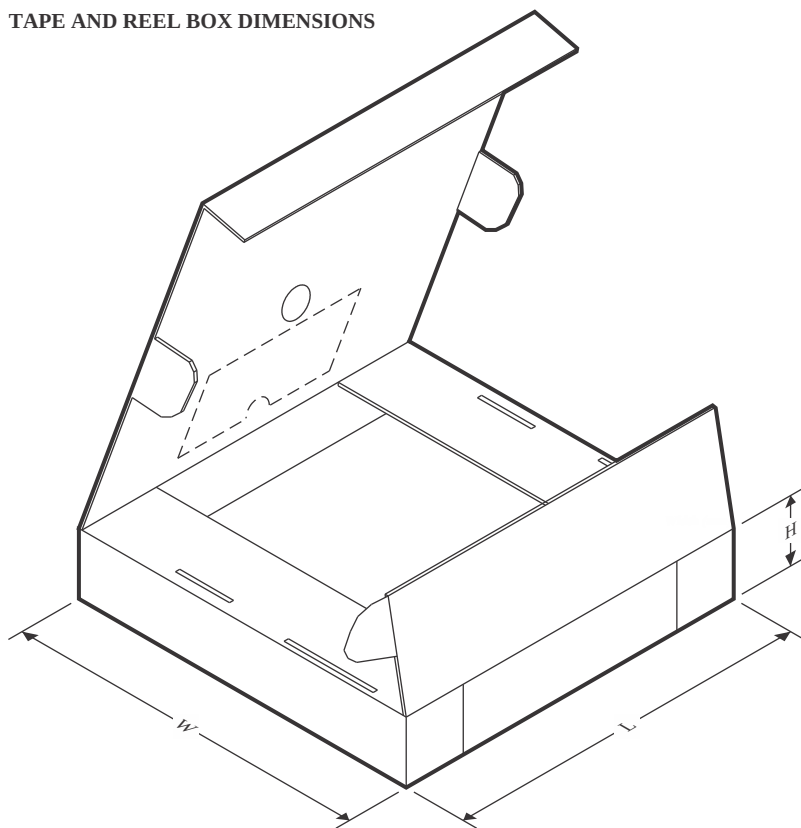
TAPE AND REEL INFORMATION



*All dimensions are nominal

Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Reel Diameter (mm)	Reel Width W1 (mm)	A0 (mm)	B0 (mm)	K0 (mm)	P1 (mm)	W (mm)	Pin1 Quadrant
ADS8515IBDBR	SSOP	DB	28	2000	330.0	16.4	8.1	10.4	2.5	12.0	16.0	Q1
ADS8515IDBR	SSOP	DB	28	2000	330.0	16.4	8.1	10.4	2.5	12.0	16.0	Q1

TAPE AND REEL BOX DIMENSIONS



*All dimensions are nominal

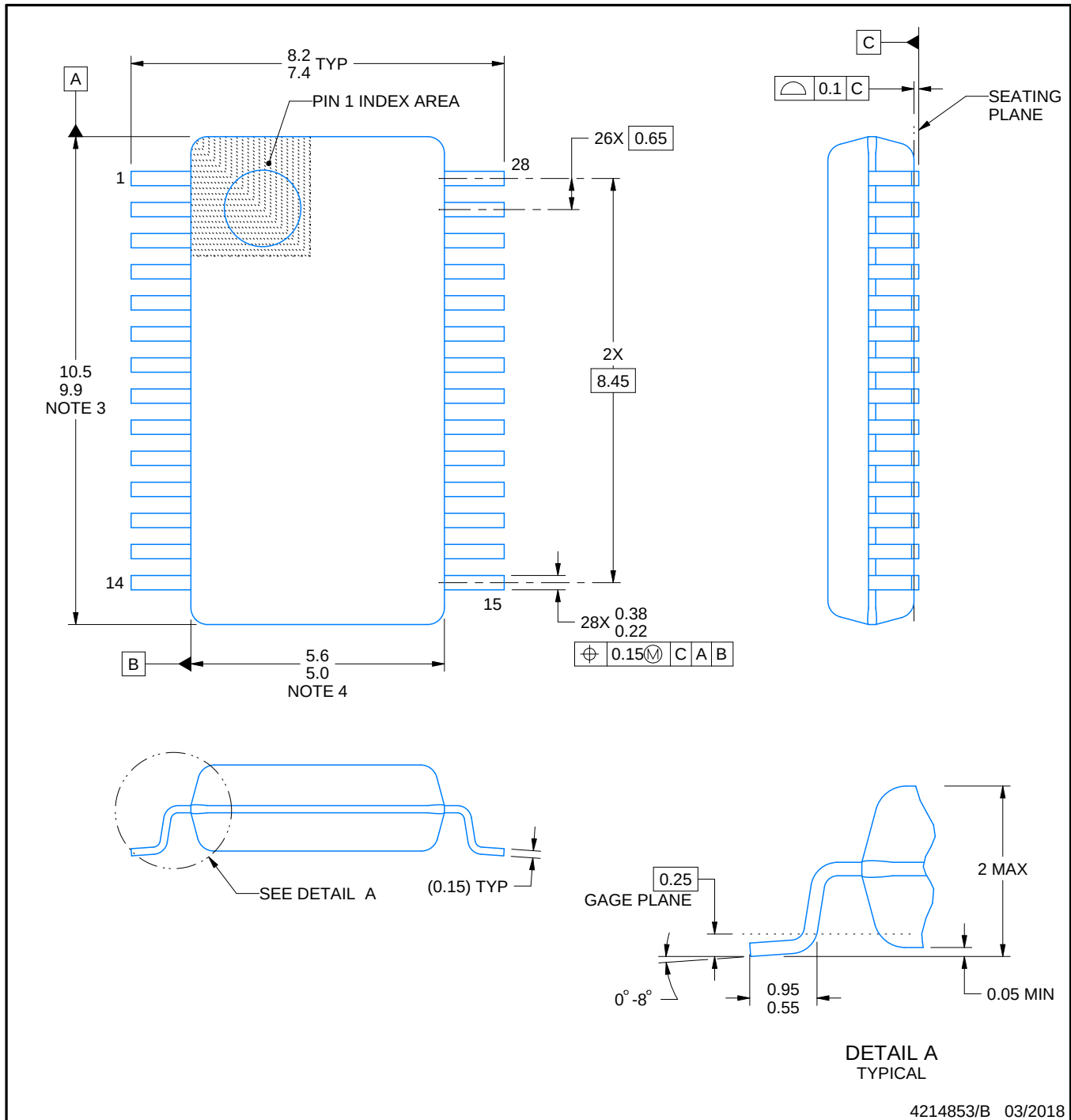
Device	Package Type	Package Drawing	Pins	SPQ	Length (mm)	Width (mm)	Height (mm)
ADS8515IBDBR	SSOP	DB	28	2000	350.0	350.0	43.0
ADS8515IDBR	SSOP	DB	28	2000	350.0	350.0	43.0

TUBE



*All dimensions are nominal

Device	Package Name	Package Type	Pins	SPQ	L (mm)	W (mm)	T (μm)	B (mm)
ADS8515IBDB	DB	SSOP	28	50	530	10.5	4000	4.1
ADS8515IBDB.A	DB	SSOP	28	50	530	10.5	4000	4.1
ADS8515IDB	DB	SSOP	28	50	530	10.5	4000	4.1
ADS8515IDB.A	DB	SSOP	28	50	530	10.5	4000	4.1



4214853/B 03/2018

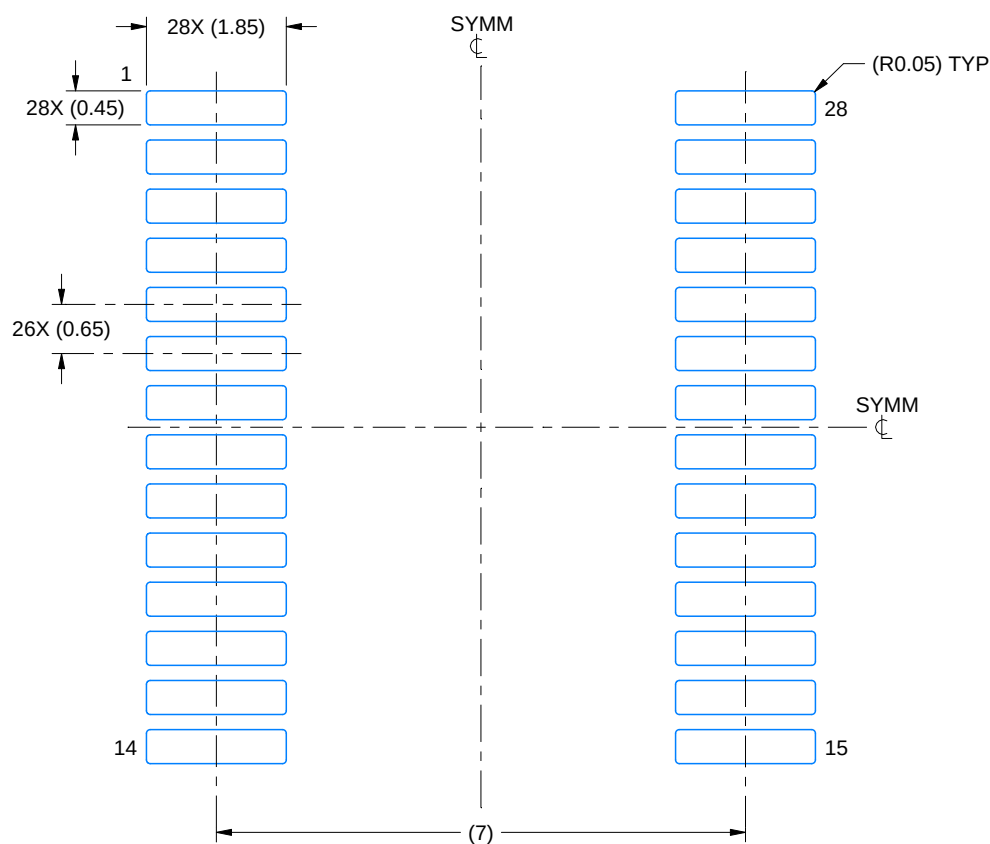
NOTES:

1. All linear dimensions are in millimeters. Any dimensions in parenthesis are for reference only. Dimensioning and tolerancing per ASME Y14.5M.
2. This drawing is subject to change without notice.
3. This dimension does not include mold flash, protrusions, or gate burrs. Mold flash, protrusions, or gate burrs shall not exceed 0.15 mm per side.
4. This dimension does not include interlead flash. Interlead flash shall not exceed 0.25 mm per side.
5. Reference JEDEC registration MO-150.

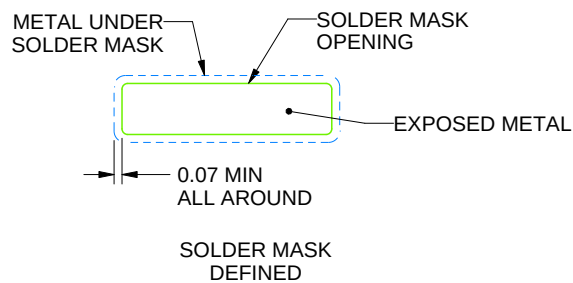
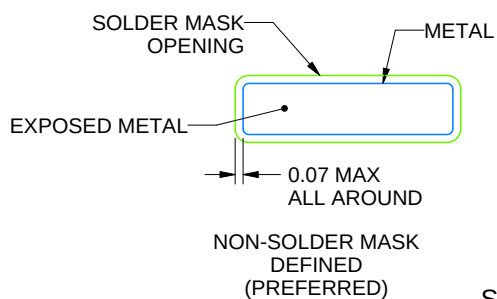
DB0028A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



LAND PATTERN EXAMPLE
EXPOSED METAL SHOWN
SCALE: 10X



SOLDER MASK DETAILS

4214853/B 03/2018

NOTES: (continued)

6. Publication IPC-7351 may have alternate designs.

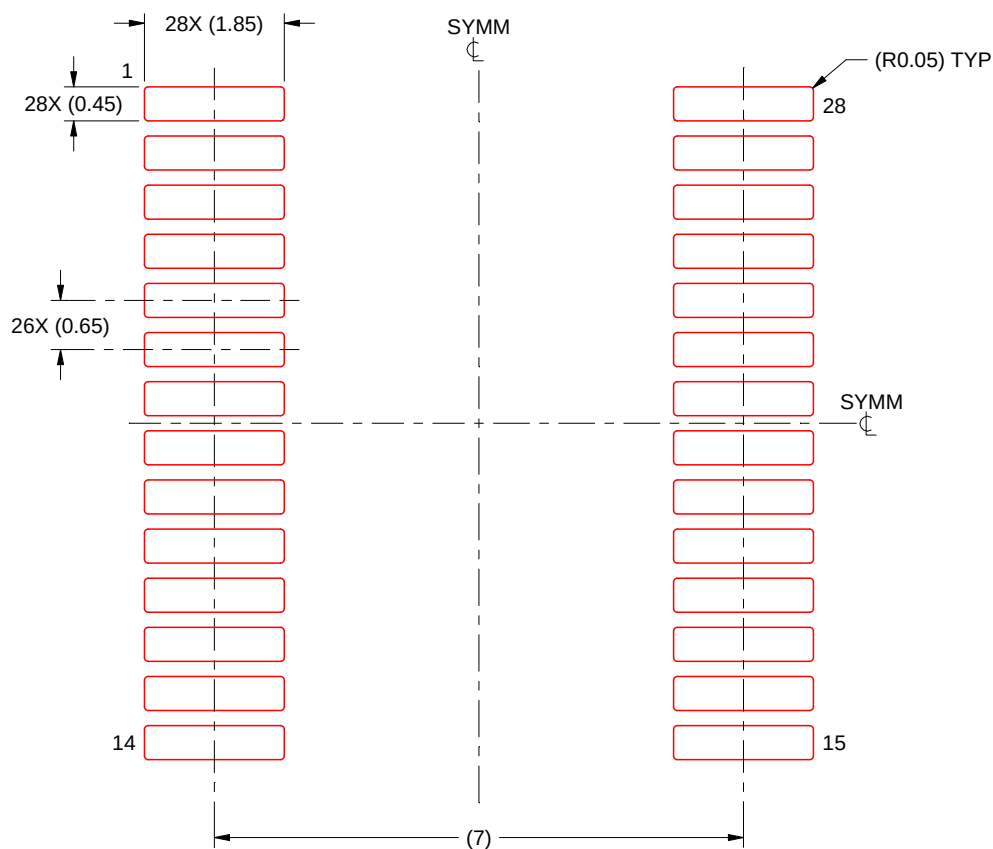
7. Solder mask tolerances between and around signal pads can vary based on board fabrication site.

EXAMPLE STENCIL DESIGN

DB0028A

SSOP - 2 mm max height

SMALL OUTLINE PACKAGE



SOLDER PASTE EXAMPLE
BASED ON 0.125 mm THICK STENCIL
SCALE: 10X

4214853/B 03/2018

NOTES: (continued)

8. Laser cutting apertures with trapezoidal walls and rounded corners may offer better paste release. IPC-7525 may have alternate design recommendations.
9. Board assembly site may have different recommendations for stencil design.

重要なお知らせと免責事項

テキサス・インスツルメンツは、技術データと信頼性データ (データシートを含みます)、設計リソース (リファレンス デザインを含みます)、アプリケーションや設計に関する各種アドバイス、Web ツール、安全性情報、その他のリソースを、欠陥が存在する可能性のある「現状のまま」提供しており、商品性および特定目的に対する適合性の黙示保証、第三者の知的財産権の非侵害保証を含むいかなる保証も、明示的または黙示的にかかわらず拒否します。

これらのリソースは、テキサス・インスツルメンツ製品を使用する設計の経験を積んだ開発者への提供を意図したものです。(1) お客様のアプリケーションに適した テキサス・インスツルメンツ製品の選定、(2) お客様のアプリケーションの設計、検証、試験、(3) お客様のアプリケーションに該当する各種規格や、その他のあらゆる安全性、セキュリティ、規制、または他の要件への確実な適合に関する責任を、お客様のみが単独で負うものとします。

上記の各種リソースは、予告なく変更される可能性があります。これらのリソースは、リソースで説明されている テキサス・インスツルメンツ製品を使用するアプリケーションの開発の目的でのみ、テキサス・インスツルメンツはその使用をお客様に許諾します。これらのリソースに関して、他の目的で複製することや掲載することは禁止されています。テキサス・インスツルメンツや第三者の知的財産権のライセンスが付与されている訳ではありません。お客様は、これらのリソースを自身で使用した結果発生するあらゆる申し立て、損害、費用、損失、責任について、テキサス・インスツルメンツおよびその代理人を完全に補償するものとし、テキサス・インスツルメンツは一切の責任を拒否します。

テキサス・インスツルメンツの製品は、[テキサス・インスツルメンツの販売条件](#)、または [ti.com](https://www.ti.com) やかかる テキサス・インスツルメンツ製品の関連資料などのいずれかを通じて提供する適用可能な条項の下で提供されています。テキサス・インスツルメンツがこれらのリソースを提供することは、適用される テキサス・インスツルメンツの保証または他の保証の放棄の拡大や変更を意味するものではありません。

お客様がいかなる追加条項または代替条項を提案した場合でも、テキサス・インスツルメンツはそれらに異議を唱え、拒否します。

郵送先住所：Texas Instruments, Post Office Box 655303, Dallas, Texas 75265
Copyright © 2025, Texas Instruments Incorporated